
XPC 使用指南

DH170 專用

Shuttle®

XPC安裝指南

版權

©2015 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

事先未經 Shuttle® Inc 書面許可，不得以任何形式或手段（電子、機械、磁性、光學、化學、影印、手冊或其他方法）複製、抄寫、儲存於檢索系統、翻譯成任何語言或傳送本指南任何內容。

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所屬人。

免責聲明

Shuttle® Inc. 對於因本產品效能或使用本產品所導致的偶然或間接損壞，概不負責。

Shuttle® Inc. 不代表或保證本手冊中的內容。雖本手冊資訊經過仔細校對，但不保證內容不會再更正。為持續改善產品，Shuttle® Inc. 保留權利隨時修改本手冊或變更本產品規格，恕不另行通知任何人或實體。本手冊中的資訊僅供客戶一般使用。

本裝置符合美國聯邦通信委員會(FCC)規則第15部分(Part 15)的規定。操作受下述兩個條件的限制：

1. 本裝置不得造成有害干擾。
2. 本裝置必須接受所接收的任何干擾，包括可能造成非其所願之操作的干擾。

商標

Shuttle 是 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 及 Pentium 是 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 是 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 是 Award Software Inc. 的註冊商標。

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

一般注意事項

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所有人。

安全資訊

請在安裝 Shuttle XPC 前閱讀以下注意安全資訊。

警告

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。
僅能依Shuttle的建議，以相同或同等的電池更換。
請依照製造商的使用說明處理廢電池。

安裝聲明

切勿在此設備上放置重物或將其置於不穩定的位置。

切勿讓此設備暴露於陽光直接照射、濕度高、或潮濕的環境中。

切勿在磁場附近使用此設備，否則磁場干擾會影響設備的性能。

切勿阻塞此設備的通風口或者以任何方式妨礙空氣流動。

規 格 說 明

處理器 & 晶片組

- Intel® LGA 1151 CPU (Barebone user configure)
- Intel® H170 高速晶片組
- Intel® HD 系列顯示晶片

記憶體 (Barebone user configure)

- 支援 2 條 240Pin DDR3L 記憶體插槽
- 支援雙通道 DDR3L 1600 記憶體, 最高可支援達 16GB 記憶體容量 (1.35 V)

硬碟機 & 光碟機 (Barebone user configure)

- 支援內接式SATA 6.0Gbs 以上之2.5吋 硬碟或SSD

內建音效 & 網路

- Realtek ALC662 音效晶片
 - 支援 HD 2.1 聲道音效
- Intel i219LM 網路晶片
 - 支援 10/100/1000 快速乙太網路
- Intel i211 網路晶片
 - 支援 10/100/1000 快速乙太網路

前置面板輸出/輸入連結埠

- 2x USB 2.0 連結埠
- 2x USB 3.0 連結埠
- 2x 音效輸出/輸入連結埠
- 1x 記憶卡讀卡機

背板後置輸出/輸入連結埠

- 2x USB 2.0 連結埠
- 2x USB 3.0 連結埠
- 1x HDMI 連結埠
- 2x DisplayPort 連結埠
- 2x RJ45 網路連結埠
- 2x RS232 COM 連結埠

測試配備

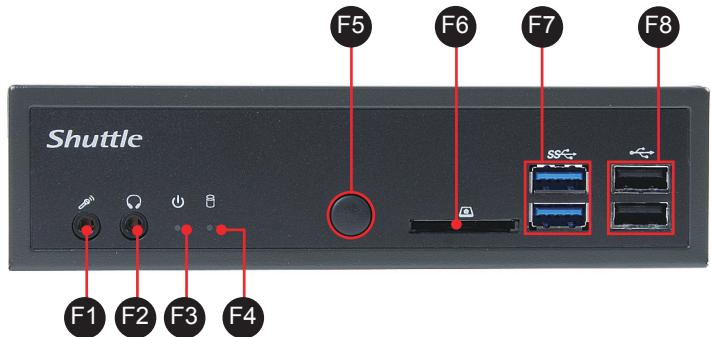
| 零組件 | 廠牌 | 型號 | 規格 |
|-------|-----------|---------------|------------------|
| 中央處理器 | Intel | I7-6700T | 2.8GHz(1151 pin) |
| 主機板 | Shuttle | FQ170/FH170 | |
| 記憶體 | Transcend | TS512MSK64W6H | 4G |
| 電源供應器 | AcBel | ADB002 | 90W |
| 電源供應器 | FSP | FSP090-DIEBN2 | 90W |
| HDD | WD | WD1600BEVT | 160GB |

規格尺寸

- 190(長) x 165(寬) x 43(高) mm
- 使用90W 電源供應器
(輸入電流值為 DC19V , 4.74A)

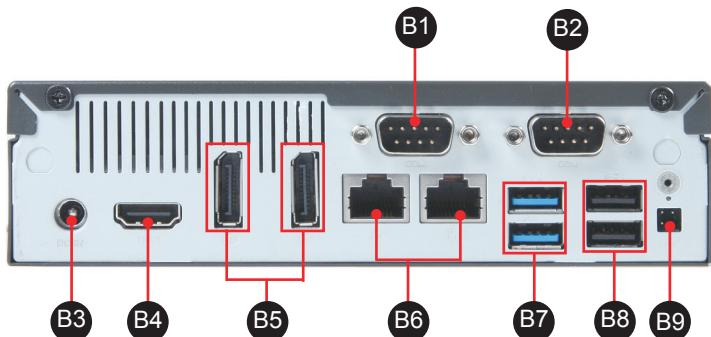
DH170 快速安裝指南【繁體中文】

正面構造



- F1. 麥克風插孔
- F2. 耳機孔
- F3. 電源指示燈
- F4. 硬碟指示燈
- F5. 電源按鈕
- F6. SD讀卡機
- F7. USB 3.0 插座
- F8. USB 2.0 插座

背面構造



- B1. COM1 連接埠
(RS232/RS422/RS485)
- B2. COM2 連接埠
(僅適用於RS232)
- B3. 電源插孔 (直流電輸入)
- B4. HDMI 連接埠
- B5. DisplayPort 連接埠
- B6. 網路連接埠
- B7. USB 3.0 插座
- B8. USB 2.0 插座
- B9. 清除COMS&POWER按鈕

限用物質含有情況標示聲明

| 設備名稱： Shuttle XPC ，型號（型式）： DH170 | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------|---|-------------------------------------|---|
| Equipment name | | Type designation (Type) | | | | |
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 機構主機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主機板 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 散熱模組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硬碟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 記憶體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中央處理器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源供應器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %” 及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.